

半導体ウェットプロセスは、半導体表面でのナノレベルでの現象解明から300mmウェハスケールでの制御まで幅広い知見が必要となる。このシンポジウムでは、この半導体ウェットプロセスに関する企業エンジニアや大学研究者のレジェンドを招待し、現在第一線で活躍する技術者・研究者と議論する場を設け、深化を続ける半導体ウェットプロセスの未来を考える。また、この業界に興味を持つ学生への学ぶ場を提供する。

プログラム

9/20(水)
開催
(現地のみ)

- **半導体基板洗浄装置の歴史とイノベーション (招待)**
荒木 浩之 (株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ)
- **半導体枚様式洗浄装置の開発について (招待)**
菅野 至 (東京エレクトロン九州株式会社)
- **半導体洗浄技術30年の歩みと今後の展望 (招待)**
富田 寛 (キオクシア株式会社)
- **バッチ式ウエハ洗浄装置内水流解析と設計の視点 (招待)**
羽深 等 (横浜国立大学)

一般講演

- ・枚葉式フッ硝酸Siエッチングにおける表面挙動の解析
- ・OpenFOAMを用いたエッチングを伴う回転円盤上での液膜流れの数値計算
- ・エッチングの理論解析-第一原理計算と機械学習ポテンシャル計算-
- ・CMOS互換プロセスで作製されたナノ共振器シリコンラマンレーザの吸収損失除去
- ・PVAブラシの変形に伴う液体流出及び流入挙動の観察
- ・誘導帯電素子を用いた二流体スプレー時の発生電荷量の制御
- ・界面ナノ電子化学研究会吸着ワーキンググループ活動報告

本シンポジウムに関する問い合わせ先

世話人

真田俊之(静岡大)、清家善之(愛知工大)、
吉水康人(キオクシア)、中森光則(東京エレクトロン九州)
sanada.toshiyuki@shizuoka.ac.jp